

7. bis 9. Mai, PCIM 2019, Halle 9, Stand 301:

Toshiba mit signifikanter Präsenz auf der PCIM Europe 2019

Toshiba zeigt führende Technologien für Automobil-, Leistungs- und Motorsteuerungs-Anwendungen

Düsseldorf, 29. April 2019 – Toshiba Electronics Europe GmbH stellt vom 7. bis 9. Mai auf der PCIM Europe aus und zeigt die neuesten Innovationen der Halbleiter- und Optoelektronik-Technologie, die sowohl die Effizienz und thermische Performance, als auch die Systemzuverlässigkeit verbessern können. Neue Lösungen für Automobil-, Leistungs- und Motorsteuerungs-Applikationen werden von Toshiba in Halle 9 am Stand 301 präsentiert.

Eines der Highlights ist Toshibas MOSFET-Technologie DTMOS VI. Damit demonstriert Toshiba weitere Fortschritte in der Entwicklung marktführender Halbleitertechnologien für höchst-effiziente Leistungs-Applikationen. Die neueste Version fokussiert auf die Schlüsselzahl (Figure-of-Merit, FoM), die auf dem Durchlasswiderstand und der Gate-Drain Ladung ($Q_{GD} * R_{(ON)}$) basiert, und ein Maß für die Reduktion der statischen und Schaltverluste ist. Toshibas DTMOS VI bietet die Best-in-Class FoM.

Die DTMOS VI Bausteine bieten die höchste Effizienz in Anwendungen wie Leistungsschalter. Sie sind im Standard TO-247 und TO-220F Gehäuse lieferbar. Ein neues SMD Package, TO-Leadless (TOLL)– einschließlich der Option einer Kelvin-Source - wird in der Zukunft eingeführt.

Automotive ist derzeit ein Schlüssel-Sektor für Leistungshalbleiter. Diese Bausteine werden unter anderem im Antriebsstrang, in Sicherheitssystemen, im Komfortbereich und in der Fahrzeugbeleuchtung eingesetzt. Verlustarme Lösungen sind kritisch für diese Applikationen, um die Wirtschaftlichkeit zu verbessern, die Emissionen konventioneller Fahrzeuge zu reduzieren und die Reichweite von EVs und HEVs zu erweitern. Toshibas automotive MOSFET-Technologien verwenden einen innovativen Kupfer-Clip als Ersatz der dünnen Aluminium Wirebonds und verbessern damit die Stromtragfähigkeit. Diese Clips reduzieren außerdem die Verluste, und sie verbessern die thermische Performance – beides ist für moderne automotive Applikationen von essentieller Bedeutung.

Die am Stand von Toshiba gezeigten Lösungen helfen den Entwicklern auch bei der Steigerung der Systemzuverlässigkeit, sowie bei der Verringerung der Baugröße und des Gewichts. Mechanische Relais unterliegen über ihre Lebensdauer hinweg einem signifikanten Verschleiß. Sie werden deshalb zunehmend durch Fotorelais ersetzt, die keine Abnutzung zeigen und höhere Zuverlässigkeit in kompakten Gehäusen aufweisen.

Die extrem kompakte VSON Foto Relais- Serie bietet eines der kleinsten derzeit verfügbaren Gehäuse. Die Bausteine basieren auf Toshiba's eigener Chip-on-Chip (COC) Technologie und messen nur 2 mm x 1,45 mm. Dies entspricht im Vergleich zu einem typischen mechanischen Relais einer signifikanten Volumenreduktion. Die Serie ist für raue Applikationsfelder ausgelegt, mit einer Betriebstemperatur bis herauf zu 110 °C.

In unserer hoch automatisierten Welt gewinnen Elektromotoren zunehmend an Popularität, sei es in Haushaltgeräten wie Klima-Anlagen oder Kühlschränken, oder in der Computer-Peripherie wie Drucker und Kopierer. Sie werden auch eingesetzt, um mechanische Pumpen und Kühlgebläse in automotiven Anwendungen zu ersetzen, sowie in neuartigen Applikationen wie ferngesteuerten Überwachungskameras.

Toshiba stellt seinen breiten Produktbereich an industriellen und automotiven Microcontrollern (MCUs), Motorsteuerungs-Treibern (MCDs) und intelligenten Leistungsbausteinen (IPDs) aus, die für den Einsatz in Bürsten-, bürstenlosen und Schrittmotoren vorgesehen sind. Mit ihrer einzigartigen Motorsteuerungs-Technologie, einschließlich integrierter Vector Engine, ermöglichen diese Bausteine eine hoch effiziente und präzise Motorsteuerung über erstaunlich breite Anwendungsbereiche.

Ebenfalls gezeigt wird Toshiba's eigene, patentierte Schaltungstechnologie 'Advanced Synchronous Reverse Blocking' (A-SRB™). Sie reduziert drastisch die Schaltverluste in den Brückenschaltungen von Invertern, DC/DC-Wandlern und PFCs – ohne den Einsatz kostspieliger Wide-Bandgap Bausteine.

Die PCIM Europe 2019 findet vom 7. bis 9. Mai in Nürnberg statt. Toshiba ist in Halle 9, am Stand 301 zu finden.

###

Über Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) ist der europäische Geschäftszweig für elektronische Komponenten [Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation](#) (Toshiba). TEE bietet europäischen Kunden und Unternehmen eine umfangreiche, innovative Auswahl an Hard Disk Drives (HDD) sowie Halbleiter Lösungen für Automotive, Industrie IoT, Motor Control, Telekommunikation und Netzwerktechnik oder für Endverbraucher- und Haushaltsgeräte-Applikationen. Das Produktsortiment des Unternehmens umfasst integrierte Wireless ICs, Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, optische Halbleiter, ASICs, ASSPs und diskrete Komponenten, von Dioden bis hin zu Logic-ICs.

Zum Hauptsitz in Düsseldorf gehören Zweigstellen in Frankreich, Italien, Schweden, Spanien und Großbritannien. Von dort aus werden Design, Marketing und Vertrieb bereitgestellt. Präsident des Unternehmens ist Mr. Tomoaki Kumagai.

Weitere Informationen über Toshiba Electronics Europe unter: www.toshiba.semicon-storage.com.

Ansprechpartner für Veröffentlichungen:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Deutschland

Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

E-mail: discrete-ic@toshiba-components.com

Ansprechpartner für die Presse:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0)193 282 2832

E-mail: MShrimpton@teu.toshiba.de

Herausgegeben durch:

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0) 20 8429 6554

Web: www.publitek.com

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com

April 2019

Ref. 7215/A